

LG이노텍 해외 R&D 인재 채용 공고

LG이노텍과 함께 부품소재를 통해 세상을 바꾸어나갈 역량 있는
R&D 전문가를 모집합니다.

[모집 대상] 북미지역 2016년 ~ 2017년 석사/박사 학위 이상 취득 예정자

※ Post Doc. 및 경력과학자 포함

[모집 기간] 2015년 11월 02일(월) ~ 2015년 12월 06일(일)

[모집 분야] R&D (연구개발) * 세부내용 2~4페이지 참고

- ❖ 소재소자 분야: 소재 및 소재 응용, 열전모듈, PKG Substrate
- ❖ 모듈부품 분야: 차량부품(무선통신, 센서, 네트워크, 모터 등),
광학, Power, 센서, LED
- ❖ 공통기술 분야: Software (지능형영상처리, 차량ECU, 네트워크),
Simulation

[지원방법] 이메일 접수 (메일 보내실 곳: monozuno@lginnotek.com)

- 첨부 양식으로 내용 작성 후, 이메일로 보내주십시오.
(CV 혹은 연구기술서를 함께 보내주시기 바랍니다.)

[전형단계] 서류전형 - 기술면접 - 임원면접 - 건강검진/처우협의

- ① 서류 전형: 이력서 검토 (당사 연구내용 적합성 평가 후 개별 연락)
- ② 기술 면접: 전화 인터뷰
- ③ 임원 면접: 기술면접 합격자에 한해 미주 현지 초청면접
- ④ 건강 검진 / 처우협의

※ 관련 문의사항은 LG이노텍 인사기획팀 정준호 차장 (02-3777-0033,
monozuno@lginnotek.com)으로 연락바랍니다.

해외 R&D 채용 부문 : 소재/소자

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
소재 소자	소재/ 소재응용/ 열전모듈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 자성소재 <ul style="list-style-type: none"> - Soft ferrite, Soft magnetic alloy, Metal-resin composite - Hard ferrite, RE magnets, RE-free magnets ■ 열전모듈 <ul style="list-style-type: none"> - 열전 소재 (저온소재, 중고온, 박막) - 열전 모듈 설계 및 모듈 공정 설계 - 박막 회로 모듈 설계 및 공정 - 열전달 경로 및 열전달 구조 설계 ■ 무기재료 <ul style="list-style-type: none"> - 금속, 세라믹, Fiber, 컴포지트 ■ 고분자재료 <ul style="list-style-type: none"> - 고분자 Film, UV수지, 고내열 수지 ■ 방열 소재 <ul style="list-style-type: none"> - 고내열성 소재합성 / 물성, - 세라믹 가공, 표면처리, 유무기 분산 / 물성, - Nano 소재 (CNT, 그래핀외), 유무기 코팅 	화학(공) 재료(공) 금속/세라믹(공) 신소재 물리/기계 기타	안산
	PKG Substrate	<ul style="list-style-type: none"> ■ 반도체 Package용 Substrate 개발 <ul style="list-style-type: none"> - Cu Patterning : Photo lithography, Cu Etching, Sputtering - Embedded Passive / Active Substrate - Cu Plating : 전해, 무전해 - Surface Finish : Electrolytic Ni/Au ENEPIG, ENIG - 고분자 재료 : Resin based Epoxy 가공, 경화 ■ Mobile용 Build-up PCB <ul style="list-style-type: none"> - Embedded PCB 	화학(공) 재료(공) 신소재 기타	구미

해외 R&D 채용 부문 : 모듈부품

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
모듈 부품	광학	▪ Camera Lens Design ▪ 회절광학 분석 및 설계 ▪ 지능형 영상처리, 디지털 신호처리, ISP (화질개선), 3D Sensing / Creation ▪ Wave Optics Design (Holography/Diffractive) ▪ Geometrical Optics Design (Head Lamp)	전기 물리 기계	안산
	Power	▪ 산업용 Power 시스템 개발 ▪ Telecom / Network 장비용 Power 개발 : 고신뢰성 설계 (방열, 방습 등 통신용 Power)	전기 전자 기계	
	센서	▪ 모바일/웨어러블/차량용 센서 개발 - 환경 : 온/습도, 공기질, 자외선, 조도 등 - 헬스 : PPG, ECG, 혈압, 혈당 등 - MEMS : 센서 플랫폼 설계 ▪ 센서신호처리 알고리즘 개발 ▪ 센서 검사/보정 시스템 개발 - 화학/광 감지 센서	전기 물리 기계 화학	
	차량 부품	무선통신 센서 네트워크	▪ 차량용 통신모듈 SW/HW 개발 - 3G/4G(WCDMA/LTE) 관련 RF, Antenna, System HW 개발 - 통신 프로토콜, Firmware SW 설계 - CAN 통신 설계 및 개발 - 해외 통신 사업자 망 인증 및 EMI/EMC 시험 ▪ BT모듈 SW/HW 개발 - BT Profile 개발 (HFP, A2DP, AVRCP 등) - BT HW 개발 . Chipset 기반 회로 설계 (CSR, BRCM 등) . MCU 적용 System 및 RF, Antenna 설계 ▪ Network 영상센서 - 임베디드 HW설계 (Arm, Mips, Power-PC 계열) - 네트워크 제품 설계 (Wi-Fi, Ethernet) - 영상제품 설계 - MCU 및 안드로이드 프로그램 개발	
			모터/ 센서	▪ 차량용 모터/센서 개발 (전자기해석, 기구설계, 구동제어) - Automotive Motor (EPS, EPP, ABS, DCT, AFS) - ECU, Traction Motor, Inverter - Torque Sensor, Oil/Water Pump, Starter Generator
	LED		▪ Chip 설계 / 공정, NanoStructure 합성 ▪ LED Chip 공정설계 / 개발	신소재

해외 R&D 채용 부문 : 공통기술

모집분야			세부 내용	유관전공	근무지
공통 기술	Soft ware	지능형 영상처리	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지능형 영상처리 : 물체/얼굴Gesture 인식, 지능형 차량 ▪ 화질 개선 (광각 왜곡 보정/저조도 성능 향상) 	컴퓨터 전기 전자 기계	안산
		차량 ECU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUTOSAR Platform - SWC 구조 설계 및 개발, Sys. Configuration ▪ Non-OS 기반 ECU S/W - Device Driver, Diagnostics, KWP2000 Protocol, Diagnostic Service Comm, CAN Calibration Protocol 		
		Network	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Network, 차량용 통신모듈 개발 S/W 802.15.4 MAC Protocol, 통신 프로토콜 설계 및 개발 : System Programming, System architect / Multi-Media / Security CDMA/WCDMA/GSM 관련 Call, Data protocol / 단말,무선모뎀 USIM(SIM) Linux or Android Device Driver/Firmware /Application 		
	Simulation		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electro-magnetic & RF Simulation (Motor & EMC) ▪ Heat transfer & Fluid dynamic Simulation ▪ Structural Simulation (Multi-Physics, Noise & Vibration, Multi-body dynamics, Optimization) 		